

研究成果報告書 (掲載期間 2019.11.1－2020.10.31)

学術書

- (1) 山田靖他：プリント配線板材料の開発と実装技術，第3章第1節 pp.55-69，技術情報協会，2020.
- (2) 山田靖,菅沼克昭他：次世代パワー半導体の熱設計と実装技術，第1章3節 pp.18-28，シーエムシー出版，2020.

審査学術論文

- (1) Y.Yamada, K.Hasegawa, Y.Ikeda, Y.Kasagi, K.Katagiri, H.Katou, H.Watanabe, A.Takenaka, H.Nagata, N.Sekine, Y.Sano : Reliability of pressure-free Cu nanoparticle joints for power electronic devices , Microelectronics Reliability, 100-101, 2019, 113316, pp.1-5.

その他

- (1) 山田靖：大学におけるエレクトロニクス実装教育，エレクトロニクス実装学会誌，23巻，2020，6号，巻頭言.